

Rockchip RK312X Linux SDK 快速入门

文档标识: RK-JC-YF-940

发布版本: V1.1.0

日期: 2022-06-20

文件密级: ☐绝密 ☐秘密 ☐内部资料 ☒公开

免责声明

本文档按“现状”提供, 瑞芯微电子股份有限公司(“本公司”, 下同)不对本文档的任何陈述、信息和内容的准确性、可靠性、完整性、适销性、特定目的性和非侵权性提供任何明示或暗示的声明或保证。本文档仅作为使用指导的参考。

由于产品版本升级或其他原因, 本文档将可能在未经任何通知的情况下, 不定期进行更新或修改。

商标声明

“Rockchip”、“瑞芯微”、“瑞芯”均为本公司的注册商标, 归本公司所有。

本文档可能提及的其他所有注册商标或商标, 由其各自拥有者所有。

版权所有© 2022 瑞芯微电子股份有限公司

超越合理使用范畴, 非经本公司书面许可, 任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部, 并不得以任何形式传播。

瑞芯微电子股份有限公司

Rockchip Electronics Co., Ltd.

地址: 福建省福州市铜盘路软件园A区18号

网址: www.rock-chips.com

客户服务电话: +86-4007-700-590

客户服务传真: +86-591-83951833

客户服务邮箱: fae@rock-chips.com

前言

概述

本文主要描述了 RK312X Linux SDK 的基本使用方法，旨在帮助开发者快速了解并使用 RK312X Linux SDK 开发包。

读者对象

本文档（本指南）主要适用于以下工程师：

技术支持工程师

软件开发工程师

各芯片系统支持状态

芯片名称	Buildroot 版本	Debian 版本	Yocto 版本	Kernel 版本
RK3126C/RK3128	2018.02-rc3	10	N/A	4.4

修订记录

日期	版本	作者	修改说明
2022-06-08	V1.0.0	Hans Yang	Release 版本
2022-06-20	V1.1.0	WJL	更新说明

目录

Rockchip RK312X Linux SDK 快速入门

1. 开发环境搭建
2. 软件开发指南
 - 2.1 开发向导
 - 2.2 芯片资料
 - 2.3 Debian 开发指南
 - 2.4 软件更新记录
3. 硬件开发指南
4. SDK 配置框架说明
 - 4.1 SDK 工程目录介绍
 - 4.2 SDK 板级配置
 - 4.3 查看编译命令
 - 4.4 自动编译
 - 4.5 各模块编译及打包
 - 4.5.1 U-Boot 编译
 - 4.5.2 Kernel 编译
 - 4.5.3 Recovery 编译
 - 4.5.4 Buildroot 编译
 - 4.5.5 Debian 编译
 - 4.5.6 交叉编译
 - 4.5.6.1 SDK 目录内置交叉编译
 - 4.5.6.2 Buildroot 内置交叉编译
 - 4.5.7 固件的打包
5. 刷机说明
 - 5.1 Windows 刷机说明
 - 5.2 Linux 刷机说明
 - 5.3 系统分区说明

1. 开发环境搭建

我们推荐使用 Ubuntu 20.04 的系统进行编译。其他的 Linux 版本可能需要对软件包做相应调整。除了系统要求外，还有其他软硬件方面的要求。

硬件要求：64 位系统，硬盘空间大于 40G。如果您进行多个构建，将需要更大的硬盘空间。

软件要求：Ubuntu 20.04 系统：

编译 SDK 环境搭建所依赖的软件包安装命令如下：

```
sudo apt-get install git ssh make gcc libssl-dev liblz4-tool expect \
g++ patchelf chrpath gawk texinfo chrpath diffstat binfmt-support \
qemu-user-static live-build bison flex fakeroot cmake gcc-multilib \
g++-multilib unzip device-tree-compiler ncurses-dev
```

建议使用 Ubuntu 20.04 系统或更高版本开发，若编译遇到报错，可以视报错信息，安装对应的软件包。

考虑客户开发环境搭建时间成本，我们也提供了交叉编译器 docker 镜像方式供客户验证，缩短编译环境搭建耗时。

参考文档 [Docker/Rockchip_Developer_Guide_Linux_Docker_Deploy_CN.pdf](#)。

Docker 编译镜像系统兼容性测试结果参考如下：

发行版本	Docker 版本	镜像加载	固件编译
ubuntu 21.10	20.10.12	pass	pass
ubuntu 21.04	20.10.7	pass	pass
ubuntu 18.04	20.10.7	pass	pass
fedora35	20.10.12	pass	NR (not run)

2. 软件开发指南

2.1 开发向导

为帮助开发工程师更快上手熟悉 SDK 的开发调试工作，随 SDK 发布

《Rockchip_Developer_Guide_Linux_Software_CN.pdf》，可在 docs 下获取，并会不断完善更新。

2.2 芯片资料

为帮助开发工程师更快上手熟悉 RK312X 的开发调试工作，随 SDK 发布 《Rockchip RK3126C Datasheet V1.1 20191107.pdf》和

《Rockchip RK3128 Datasheet V1.2 20170720.pdf》芯片手册。

2.3 Debian 开发指南

为帮助开发工程师更快上手熟悉 RK312X Debian 的开发调试，随 SDK 发布

《Rockchip_Developer_Guide_Debian_CN.pdf》开发指南，可在 docs/ApplicationNote 下获取，并会不断完善更新。

2.4 软件更新记录

软件发布版本升级通过工程 xml 进行查看，具体方法如下：

```
.repo/manifests$ realpath rk312x_linux_release.xml
# 例如:打印的版本号为v1.4.0, 更新时间为20220620
# <SDK>/.repo/manifests/rk312x_linux_release_v1.4.0_20220620.xml
```

软件发布版本升级更新内容通过工程文本可以查看，具体方法如下：

```
.repo/manifests$ cat RK312X_Linux_SDK_Note.md
```

或者参考工程目录：

```
<SDK>/docs/RK312X/RK312X_Linux_SDK_Note.md
```

3. 硬件开发指南

硬件相关开发可以参考用户使用指南，在工程目录：

RK3126C/RK3128 EVB 硬件设计指南：

```
<SDK>/docs/RK312X/Hardware/Rockchip_RK3126C_Hardware_Design_Guide_V1.0_CN.pdf
<SDK>/docs/RK312X/Hardware/Rockchip_RK3128_Hardware_Design_Guide_V0.1_CN.pdf
```

RK3126C/RK3128 EVB 硬件开发指南：

```
<SDK>/docs/RK312X/Hardware/Rockchip_RK3126C_EVB_User_Guide_V1.0_20220512_CN.pdf
<SDK>/docs/RK312X/Hardware/Rockchip_RK3128_EVB_User_Guide_V1.0_20220512_CN.pdf
```

4. SDK 配置框架说明

4.1 SDK 工程目录介绍

SDK目录包含有 buildroot、debian、recovery、app、kernel、u-boot、device、docs、external 等目录。每个目录或其子目录会对应一个 git 工程，提交需要在各自的目录下进行。

- app：存放上层应用 APP
- buildroot：基于 Buildroot（2018.02-rc3）开发的根文件系统。
- debian：基于 Debian 10 开发的根文件系统。
- device/rockchip：存放各芯片板级配置以及一些编译和打包固件的脚本和预备文件。
- docs：存放开发指导文件、平台支持列表、工具使用文档、Linux 开发指南等。
- IMAGE：存放每次生成编译时间、XML、补丁和固件目录。
- external：存放第三方相关仓库，包括音频、视频、网络、recovery 等。
- kernel：存放 Kernel 4.4 开发的代码。
- prebuilts：存放交叉编译工具链。
- rkbin：存放 Rockchip 相关 Binary 和工具。
- rockdev：存放编译输出固件。
- tools：存放 Linux 和 Window 操作系统下常用工具。
- u-boot：存放基于 v2017.09 版本进行开发的 U-Boot 代码。

4.2 SDK 板级配置

进入工程 `<SDK>/device/rockchip/rk312x` 目录：

板级配置	说明
BoardConfig-rk3126c-evb-ddr3-v10-debian.mk	适用于 RK3126 EVB 搭配 DDR3 开发板，适配 Debian 系统
BoardConfig-rk3126c-evb-ddr3-v10-slc-nand.mk	适用于 RK3126 EVB 搭配 DDR3 开发板，SLC NAND方案，适配Ubifs文件系统
BoardConfig-rk3126c-evb-ddr3-v10.mk	适用于 RK3126 EVB 搭配 DDR3 开发板
BoardConfig-rk3128-evb-ddr3-v10-debian.mk	适用于 RK3128 EVB 搭配 DDR3 开发板，适配 Debian 系统
BoardConfig-rk3128-evb-ddr3-v10.mk	适用于 RK3128 EVB 搭配 DDR3 开发板
BoardConfig.mk	默认配置

方法一：

`./build.sh` 后面加上板级配置文件, 例如：

选择适用于 **RK3126 EVB 搭配 DDR3 开发板，适配 Debian 系统**的板级配置

```
./build.sh device/rockchip/rk312x/BoardConfig-rk3126c-evb-ddr3-v10-debian.mk
```

选择适用于 **RK3126 EVB 搭配 DDR3 开发板，SLC NAND方案**的板级配置：

```
./build.sh device/rockchip/rk312x/BoardConfig-rk3126c-evb-ddr3-v10-slc-nand.mk
```

选择适用于 **RK3126 EVB 搭配 DDR3 开发板** 的板级配置：

```
./build.sh device/rockchip/rk312x/BoardConfig-rk3126c-evb-ddr3-v10.mk
```

选择适用于 **RK3128 EVB 搭配 DDR3 开发板，适配 Debian 系统** 的板级配置：

```
./build.sh device/rockchip/rk312x/BoardConfig-rk3128-evb-ddr3-v10-debian.mk
```

选择适用于 **RK3128 EVB 搭配 DDR3 开发板** 的板级配置：

```
./build.sh device/rockchip/rk312x/BoardConfig-rk3128-evb-ddr3-v10.mk
```

方法二：

```
rk312x$ ./build.sh lunch
processing option: lunch

You're building on Linux
Lunch menu...pick a combo:

0. default BoardConfig.mk
1. BoardConfig-rk3126c-evb-ddr3-v10-debian.mk
2. BoardConfig-rk3126c-evb-ddr3-v10-slc-nand.mk
3. BoardConfig-rk3126c-evb-ddr3-v10.mk
4. BoardConfig-rk3128-evb-ddr3-v10-debian.mk
5. BoardConfig-rk3128-evb-ddr3-v10.mk
6. BoardConfig.mk
Which would you like? [0]:
...
```

4.3 查看编译命令

在根目录执行命令：`./build.sh -h|help`

```
rk312x$ ./build.sh -h
Usage: build.sh [OPTIONS]
Available options:
BoardConfig*.mk  -switch to specified board config
lunch            -list current SDK boards and switch to specified board config
uboot            -build uboot
spl              -build spl
loader           -build loader
kernel           -build kernel
modules          -build kernel modules
toolchain        -build toolchain
rootfs           -build default rootfs, currently build buildroot as default
buildroot        -build buildroot rootfs
ramboot          -build ramboot image
```

```

multi-npu_boot    -build boot image for multi-npu board
yocto              -build yocto rootfs
debian            -build debian rootfs
pcba              -build pcba
recovery          -build recovery
all               -build uboot, kernel, rootfs, recovery image
cleanall          -clean uboot, kernel, rootfs, recovery
firmware          -pack all the image we need to boot up system
updateimg         -pack update image
otapackage        -pack ab update otapackage image (update_ota.img)
sdpackage         -pack update sdcard package image (update_sdcard.img)
save              -save images, patches, commands used to debug
allsave           -build all & firmware & updateimg & save
check             -check the environment of building
info              -see the current board building information
app/<pkg>          -build packages in the dir of app/*
external/<pkg>     -build packages in the dir of external/*

createkeys        -create secureboot root keys
security_rootfs   -build rootfs and some relevant images with security paramter
(just for dm-v)
security_boot     -build boot with security paramter
security_uboot    -build uboot with security paramter
security_recovery -build recovery with security paramter
security_check    -check security paramter if it's good

Default option is 'allsave'.

```

查看部分模块详细编译命令，例如：`./build.sh -h kernel`

```

rk312x$ ./build.sh -h kernel
###Current SDK Default [ kernel ] Build Command###
cd kernel
make ARCH=arm rockchip_linux_defconfig rk3126_linux.config
make ARCH=arm rk3126c-evb-ddr3-v10-linux.img -j12

```

4.4 自动编译

进入工程根目录执行以下命令自动完成所有的编译：

```

./build.sh all # 只编译模块代码 (U-Boot, Kernel, Rootfs, Recovery)
               # 需要再执行./mkfirmware.sh 进行固件打包

./build.sh     # 在./build.sh all基础上
               # 1. 增加固件打包 ./mkfirmware.sh
               # 2. update.img打包
               # 3. 复制rockdev目录下的固件到IMAGE/***_RELEASE_TEST/IMAGES目录
               # 4. 保存各个模块的补丁到IMAGE/***_RELEASE_TEST/PATCHES目录
               # 注: ./build.sh 和 ./build.sh allsave 命令一样

```

默认是 Buildroot，可以通过设置环境变量 `RK_ROOTFS_SYSTEM` 指定 rootfs。`RK_ROOTFS_SYSTEM` 目前可设定两个类型：`buildroot` 和 `debian`。

如需要 debain 可以通过以下命令进行生成：

```
$export RK_ROOTFS_SYSTEM=debian
$./build.sh
```

4.5 各模块编译及打包

4.5.1 U-Boot 编译

```
### U-Boot编译命令
./build.sh uboot

### 查看U-Boot详细编译命令
./build.sh -h uboot
```

4.5.2 Kernel 编译

```
### Kernel编译命令
./build.sh kernel

### 查看kernel详细编译命令
./build.sh -h kernel
```

4.5.3 Recovery 编译

```
### Recovery编译命令
./build.sh recovery

### 查看Recovery详细编译命令
./build.sh -h recovery
```

注：Recovery是非必需的功能，有些板级配置不会设置

4.5.4 Buildroot 编译

进入工程目录根目录执行以下命令自动完成 Rootfs 的编译及打包：

```
./build.sh rootfs
```

编译后在 Buildroot 目录 output/rockchip_rk3126c/images下生成 rootfs.ext4。

4.5.5 Debian 编译

```
./build.sh debian
```

或进入 debian/ 目录:

```
cd debian/
```

后续的编译和 Debian 固件生成请参考当前目录 readme.md。

(1) Building base Debian system

```
sudo apt-get install binfmt-support qemu-user-static live-build  
sudo dpkg -i ubuntu-build-service/packages/*  
sudo apt-get install -f
```

编译 32 位的 Debian:

```
RELEASE=buster TARGET=desktop ARCH=armhf ./mk-base-debian.sh
```

编译完成会在 debian/ 目录下生成: linaro-buster-alip-xxxxx-1.tar.gz (xxxxx 表示生成时间戳)。

FAQ:

- 上述编译如果遇到如下问题情况:

```
noexec or nodev issue /usr/share/debootstrap/functions: line 1450:  
....../rootfs/ubuntu-build-service/buster-desktop-arm64/chroot/test-dev-null:  
Permission denied E: Cannot install into target '/rootfs/ubuntu-build-  
service/buster-desktop-arm64/chroot' mounted with noexec or nodev
```

解决方法:

```
mount -o remount,exec,dev xxx (xxx 是工程目录), 然后重新编译
```

另外如果还有遇到其他编译异常, 先排除使用的编译系统是 ext2/ext4 的系统类型。

- 由于编译 Base Debian 需要访问国外网站, 而国内网络访问国外网站时, 经常出现下载失败的情况:

Debian 使用 live build, 镜像源改为国内可以这样配置:

```

+++ b/ubuntu-build-service/buster-desktop-arm64/configure
@@ -11,6 +11,11 @@ set -e
echo "I: create configuration"
export LB_BOOTSTRAP_INCLUDE="apt-transport-https gnupg"
lb config \
+ --mirror-bootstrap "https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/debian" \
+ --mirror-chroot "https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/debian" \
+ --mirror-chroot-security "https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/debian-security" \
+ --mirror-binary "https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/debian" \
+ --mirror-binary-security "https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/debian-security"
--apt-indices false \
--apt-recommends false \
--apt-secure false \

```

如果其他网络原因不能下载包，有预编生成的包分享在[百度云网盘](#)，放在当前目录直接执行下一步操作。

(2) Building rk-debian rootfs

编译 32位的 Debian:

```
VERSION=debug ARCH=armhf ./mk-rootfs-buster.sh
```

(3) Creating the ext4 image(linaro-rootfs.img)

```
./mk-image.sh
```

此时会生成 linaro-rootfs.img。

4.5.6 交叉编译

4.5.6.1 SDK 目录内置交叉编译

SDK prebuilts 目录预置交叉编译，如下：

目录	说明
prebuilts/gcc/linux-x86/arm/gcc-linaro-6.3.1-2017.05-x86_64_arm-linux-gnueabi	gcc arm 6.3.1 32位工具链

4.5.6.2 Buildroot 内置交叉编译

若需要编译单个模块或者第三方应用，需对交叉编译环境进行配置。比如 RK3126C，其交叉编译工具位于

`buildroot/output/rockchip_rk3126c/host/usr` 目录下，需要将工具的 `bin/` 目录和 `arm-buildroot-linux-gnueabi/bin/` 目录设为环境变量，在顶层目录执行自动配置环境变量的脚本：

```
source envsetup.sh
```

输入命令查看:

```
cd buildroot/output/rockchip_rk3126c/host/usr/bin  
./arm-linux-gcc --version
```

此时会打印如下信息:

```
arm-linux-gcc.br_real (Buildroot 2018.02-rc3-g20055997) 10.3.0
```

比如 busybox 模块, 常用相关编译命令如下:

- 编译 busybox

```
SDK$make busybox
```

- 重编 busybox

```
SDK$make busybox-rebuild
```

- 删除 busybox

```
SDK$make busybox-dirclean
```

或者

```
SDK$rm -rf /buildroot/output/rockchip_rk3588/build/busybox-1.34.1
```

4.5.7 固件的打包

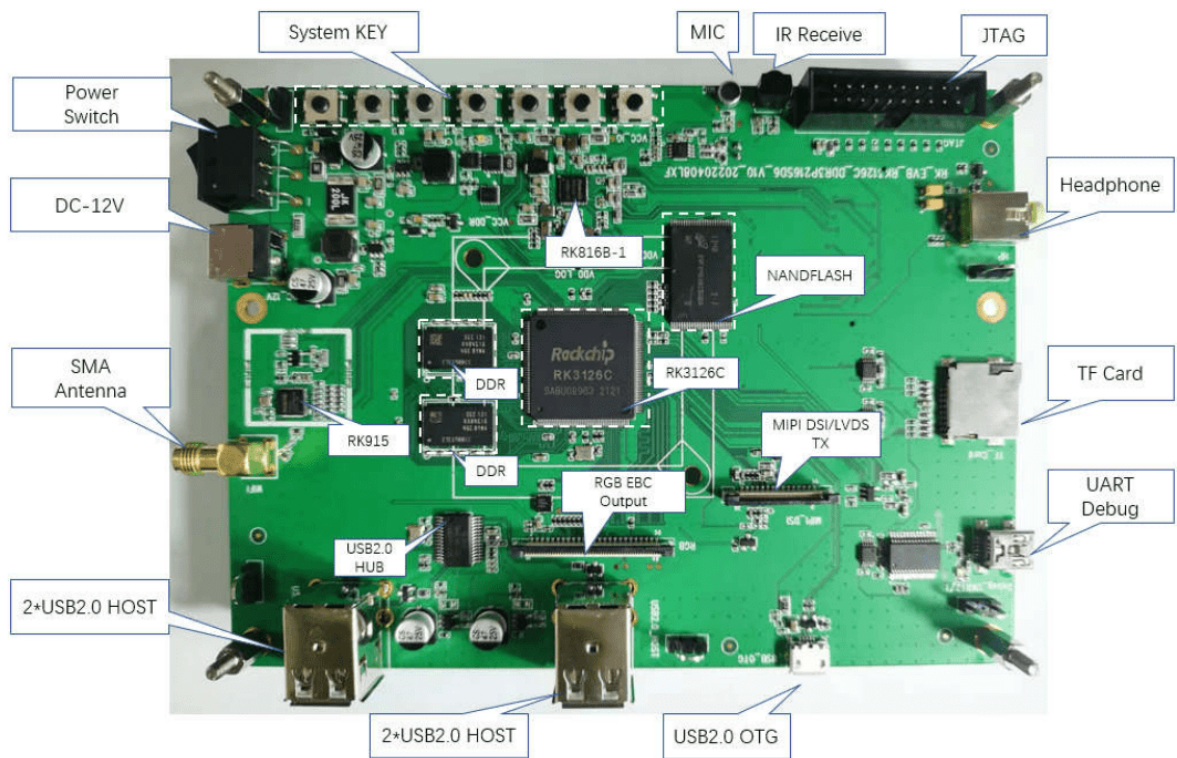
上面 Kernel/U-Boot/Recovery/Rootfs 各个部分的编译后, 进入工程目录根目录执行以下命令自动完成所有固件打包到 rockdev 目录下:

固件生成:

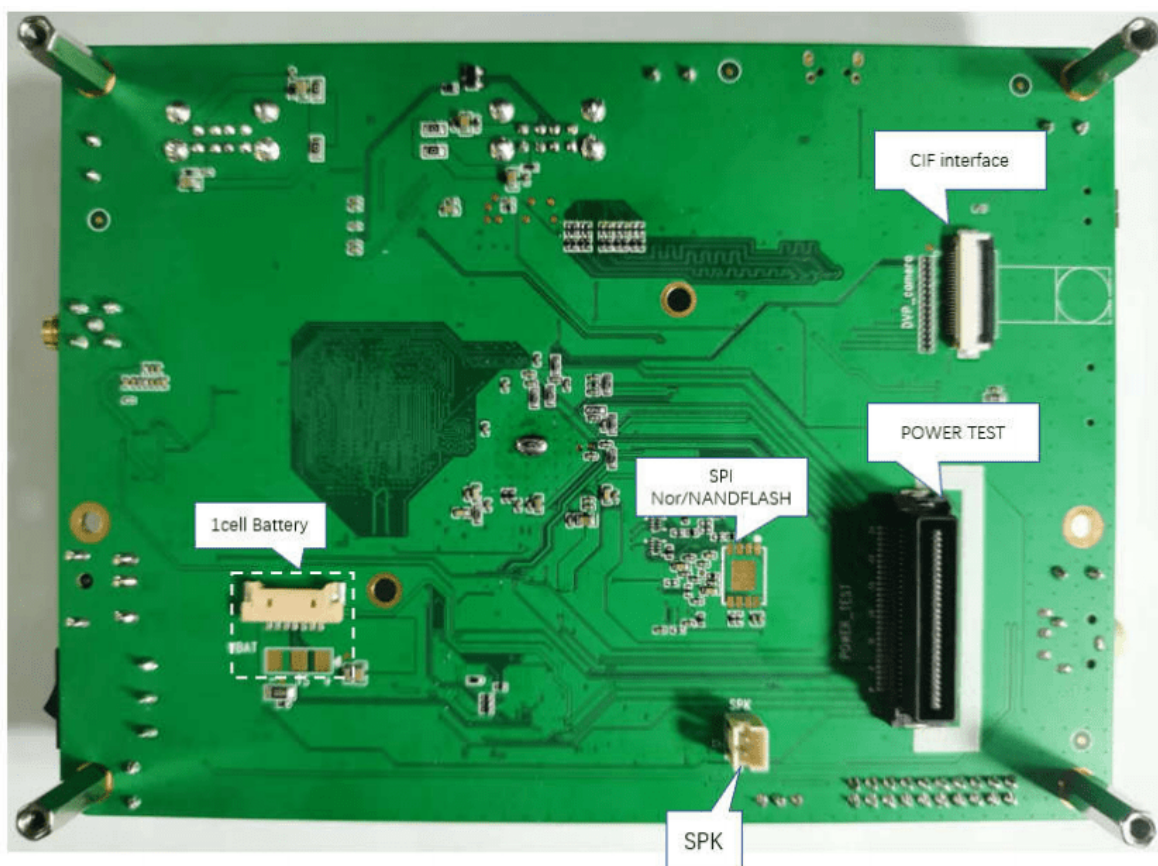
```
./mkfirmware.sh
```

5. 刷机说明

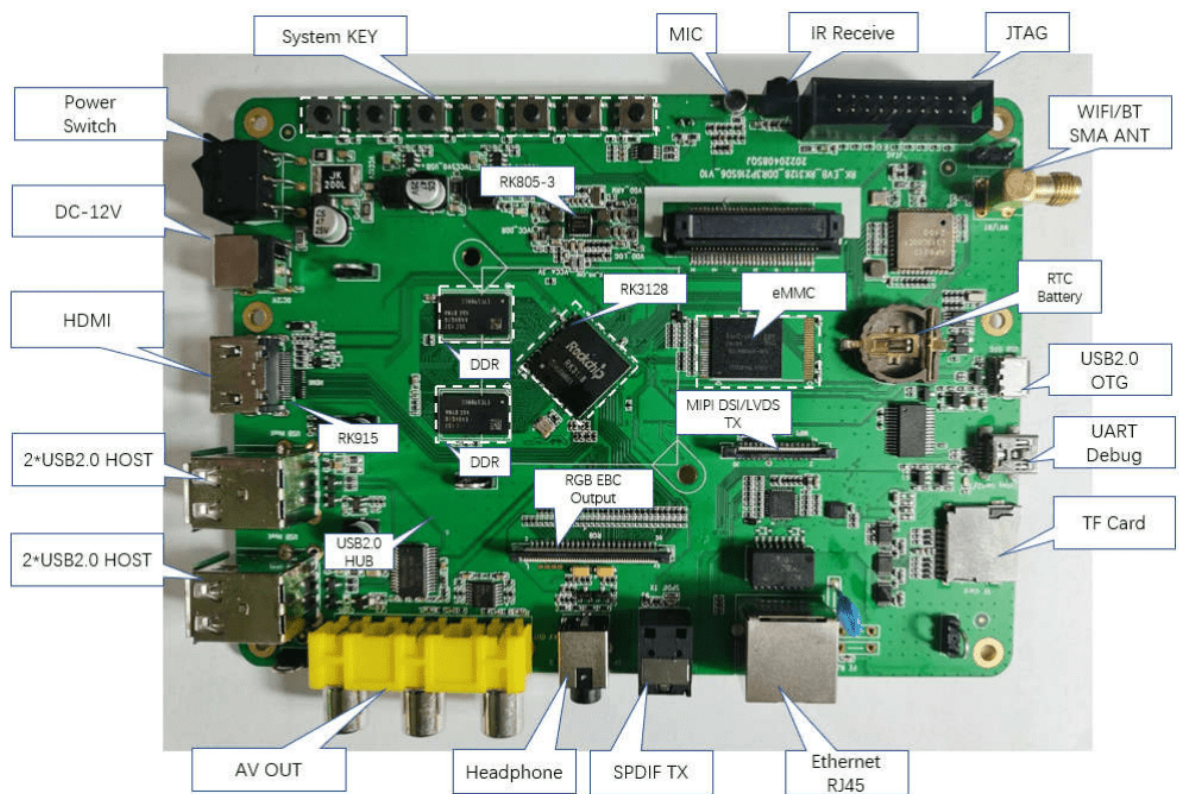
RK3126C EVB 开发板正面接口分布图如下:



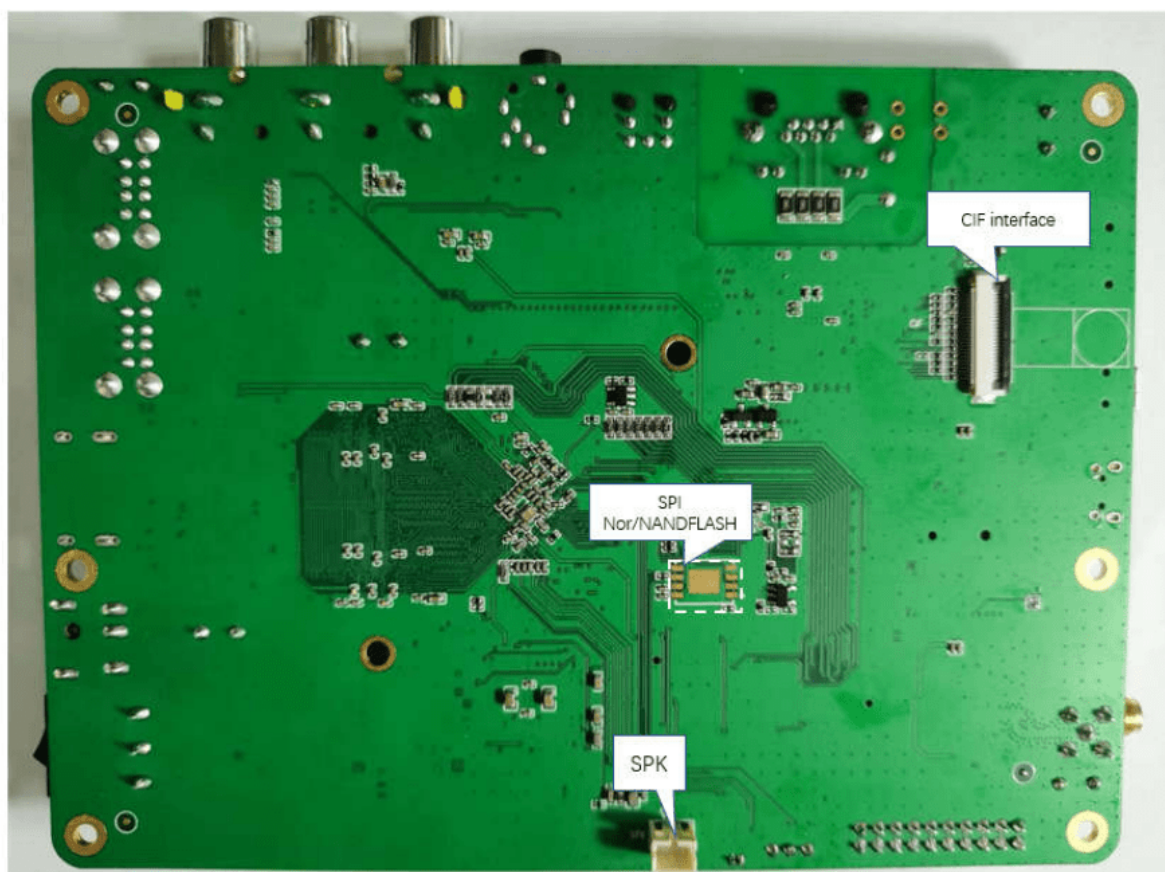
RK3126C EVB 开发板背面接口分布图如下：



RK3128 EVB 开发板正面接口分布图如下：



RK3128 EVB 开发板背面接口分布图如下：



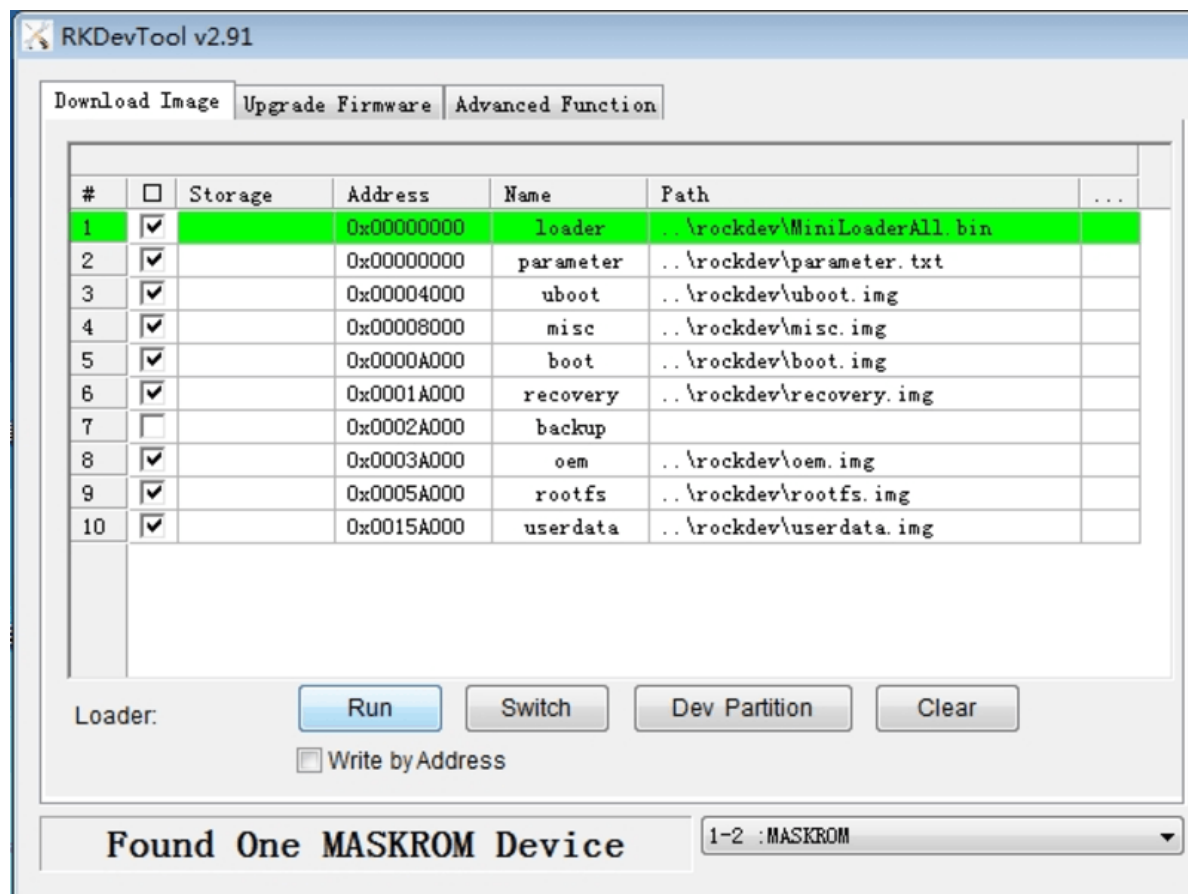
5.1 Windows 刷机说明

SDK 提供 Windows 烧写工具(工具版本需要 V2.91 或以上)，工具位于工程根目录：

```
tools/
└─ windows/RKDevTool
```

如下图，编译生成相应的固件后，设备烧写需要进入 MASKROM 或 BootROM 烧写模式，连接好 USB 下载线后，按住按键“MASKROM”不放并按下复位键“RST”后松手，就能进入 MASKROM 模式，加载编译生成固件的相应路径后，点击“执行”进行烧写，也可以按“recovery”按键不放并按下复位键“RST”后松手进入 loader 模式进行烧写，下面是 MASKROM 模式的分区偏移及烧写文件。

(注意：Windows PC 需要在管理员权限运行工具才可执行)



注：烧写前，需安装最新 USB 驱动，驱动详见：

```
<SDK>/tools/windows/DriverAssitant_v5.11.zip
```

5.2 Linux 刷机说明

Linux 下的烧写工具位于 tools/linux 目录下(Linux_Upgrade_Tool 工具版本需要 V2.1 或以上)，请确认你的板子连接到 MASKROM/loader rockusb。比如编译生成的固件在 rockdev 目录下，升级命令如下：

```
sudo ./upgrade_tool ul -noreset rockdev/MiniLoaderAll.bin
sudo ./upgrade_tool di -p rockdev/parameter.txt
sudo ./upgrade_tool di -u rockdev/uboot.img
sudo ./upgrade_tool di -misc rockdev/misc.img
sudo ./upgrade_tool di -b rockdev/boot.img
sudo ./upgrade_tool di -recovery rockdev/recovery.img
sudo ./upgrade_tool di -oem rockdev/oem.img
sudo ./upgrade_tool di -rootfs rockdev/rootfs.img
sudo ./upgrade_tool di -userdata rockdev/userdata.img
sudo ./upgrade_tool rd
```

或升级打包后的完整固件：

```
sudo ./upgrade_tool uf rockdev/update.img
```

或在根目录， 机器在 MASKROM 状态运行如下升级：

```
./rkflash.sh
```

5.3 系统分区说明

默认分区说明

Number	Name
1	uboot
2	misc
3	boot
4	recovery
5	bakcup
6	rootfs
7	oem
8	userdata

- uboot 分区：供 uboot 编译出来的 uboot.img。
- misc 分区：供 misc.img，给 recovery 使用。
- boot 分区：供 kernel 编译出来的 boot.img。
- recovery 分区：供 recovery 编译出的 recovery.img。
- backup 分区：预留，暂时没有用，后续跟 Android 一样作为 recovery 的 backup 使用。
- rootfs 分区：供 buildroot、或 debian 编出来的 rootfs.img。
- oem 分区：给厂家使用，存放厂家的 APP 或数据。挂载在 /oem 目录。
- userdata 分区：供 APP 临时生成文件或给最终用户使用，挂载在 /userdata 目录下。

